

# Schnelle GaAs-IR-Lumineszenzdiode (950 nm) High-Speed GaAs Infrared Emitter (950 nm)

## SFH 4200 SFH 4205



SFH 4200



SFH 4205

### Wesentliche Merkmale

- GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
- Gleichstrom- (mit Modulation) oder Impulsbetrieb möglich
- Hohe Zuverlässigkeit
- Hohe Impulsbelastbarkeit
- Sehr kurze Schaltzeiten (10 ns)
- Für Oberflächenmontage geeignet
- Gegurtet lieferbar
- SFH 4200 Gehäusegleich mit SFH 320
- SFH 4205 Gehäusegleich mit SFH 325
- SFH 4205: Nur für IR-Reflow-Lötung geeignet.

### Anwendungen

- Schnelle Datenübertragung mit Übertragungsraten bis 100 Mbaud (IR Tastatur, Joystick, Multimedia)
- Analoge und digitale Hi-Fi Audio- und Videosignalübertragung
- Batteriebetriebene Geräte (geringe Stromaufnahme)
- Anwendungen mit hohen Zuverlässigkeitsansprüchen bzw. erhöhten Anforderungen
- Alarm- und Sicherungssysteme
- IR Freiraumübertragung

### Features

- Very highly efficient GaAs-LED
- DC (with modulation) or pulsed operations are possible
- High reliability
- High pulse handling capability
- Very short switching times (10 ns)
- Suitable for surface mounting (SMT)
- Available on tape and reel
- SFH 4200 same package as SFH 320
- SFH 4205 same package as SFH 325
- SFH 4205: Suitable only for IR-reflow soldering.

### Applications

- High data transmission rate up to 100 Mbaud (IR keyboard, Joystick, Multimedia)
- Analog and digital Hi-Fi audio and video signal transmission
- Low power consumption (battery) equipment
- Suitable for professional and high-reliability applications
- Alarm and safety equipment
- IR free air transmission

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gehäuse Package
SFH 4200 SFH 4205	Q62702-P978 Q62702-P5165	Kathodenkennzeichnung: abgesetzte Ecke Cathode marking: bevelled edge TOPLED® SIDELED

**Grenzwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )  
**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 40 ... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	3	V
Durchlaßstrom Forward current	$I_F$ (DC)	100	mA
Stoßstrom, $t_p = 10\text{ }\mu\text{s}$ , $D = 0$ Surge current	$I_{FSM}$	1	A
Verlustleistung Power dissipation	$P_{tot}$	180	mW
Wärmewiderstand Sperrschicht - Umgebung bei Montage auf FR4 Platine, Padgröße je $16\text{ mm}^2$ Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), padsize $16\text{ mm}^2$ each	$R_{thJA}$	450	K/W
Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle bei Montage auf Metall-Block Thermal resistance junction - soldering point, mounted on metal block	$R_{thJS}$	200	K/W

Kennwerte ( $T_A = 25\text{ °C}$ )

## Characteristics

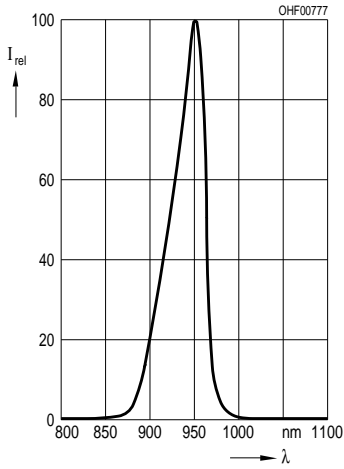
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\lambda_{\text{peak}}$	950	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{\text{max}}$ Spectral bandwidth at 50% of $I_{\text{max}}$ $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\Delta\lambda$	40	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 60$	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	0.09	mm <sup>2</sup>
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimensions of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	$0.3 \times 0.3$	mm
Schaltzeiten, $I_e$ von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, bei $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ , $R_L = 50\ \Omega$ Switching times, $I_e$ from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ , $R_L = 50\ \Omega$	$t_r$ , $t_f$	10	ns
Durchlaßspannung, Forward voltage $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$ $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$	$V_F$ $V_F$	1.5 ( $\leq 1.8$ ) 3.2 ( $\leq 3.6$ )	V V
Sperrstrom, Reverse current $V_R = 3\text{ V}$	$I_R$	0.01 ( $\leq 10$ )	$\mu\text{A}$
Gesamtstrahlungsfluß, Total radiant flux $I_F = 100\text{ mA}$ , $t_p = 20\text{ ms}$	$\Phi_e$	28	mW
Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_I$	- 0.44	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $V_F$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_V$	- 1.5	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda$ , $I_F = 100\text{ mA}$ Temperature coefficient of $\lambda$ , $I_F = 100\text{ mA}$	$TC_\lambda$	+ 0.2	nm/K

**Strahlstärke  $I_e$  in Achsrichtung**gemessen bei einem Raumwinkel  $\Omega = 0.01$  sr**Radiant Intensity  $I_e$  in Axial Direction**at a solid angle of  $\Omega = 0.01$  sr

Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 100$ mA, $t_p = 20$ ms	$I_{e \text{ min.}}$ $I_{e \text{ typ.}}$	4 8.5	mW/sr mW/sr
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1$ A, $t_p = 100$ $\mu$ s	$I_{e \text{ typ.}}$	55	mW/sr

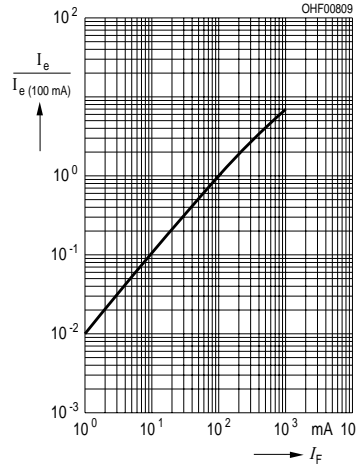
**Relative Spectral Emission**

$I_{rel} = f(\lambda)$



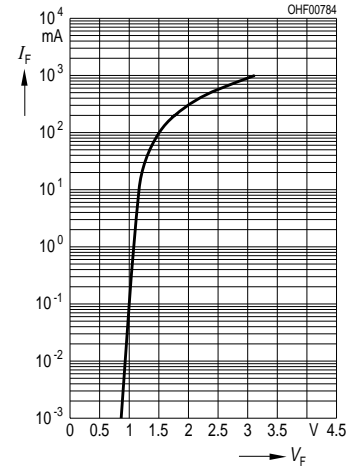
**Radiant Intensity**  $\frac{I_e}{I_e 100 \text{ mA}} = f(I_F)$

Single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$



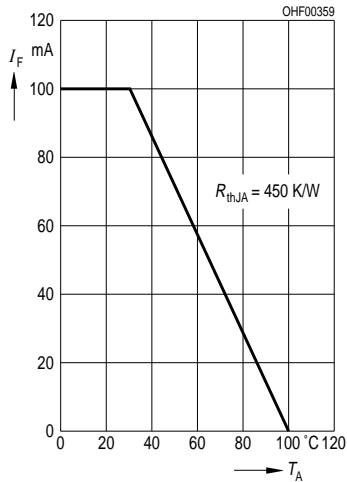
**Forward Current**  $I_F = f(V_F)$

single pulse,  $t_p = 20 \mu\text{s}$

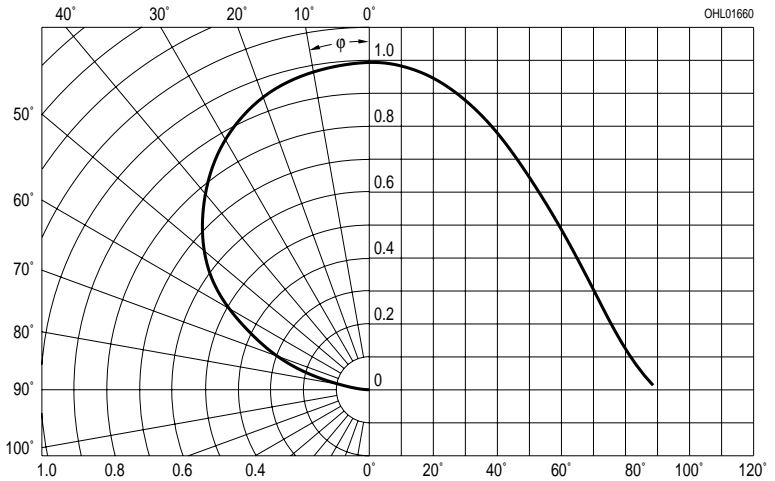


**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T_A, R_{thJA})^1$

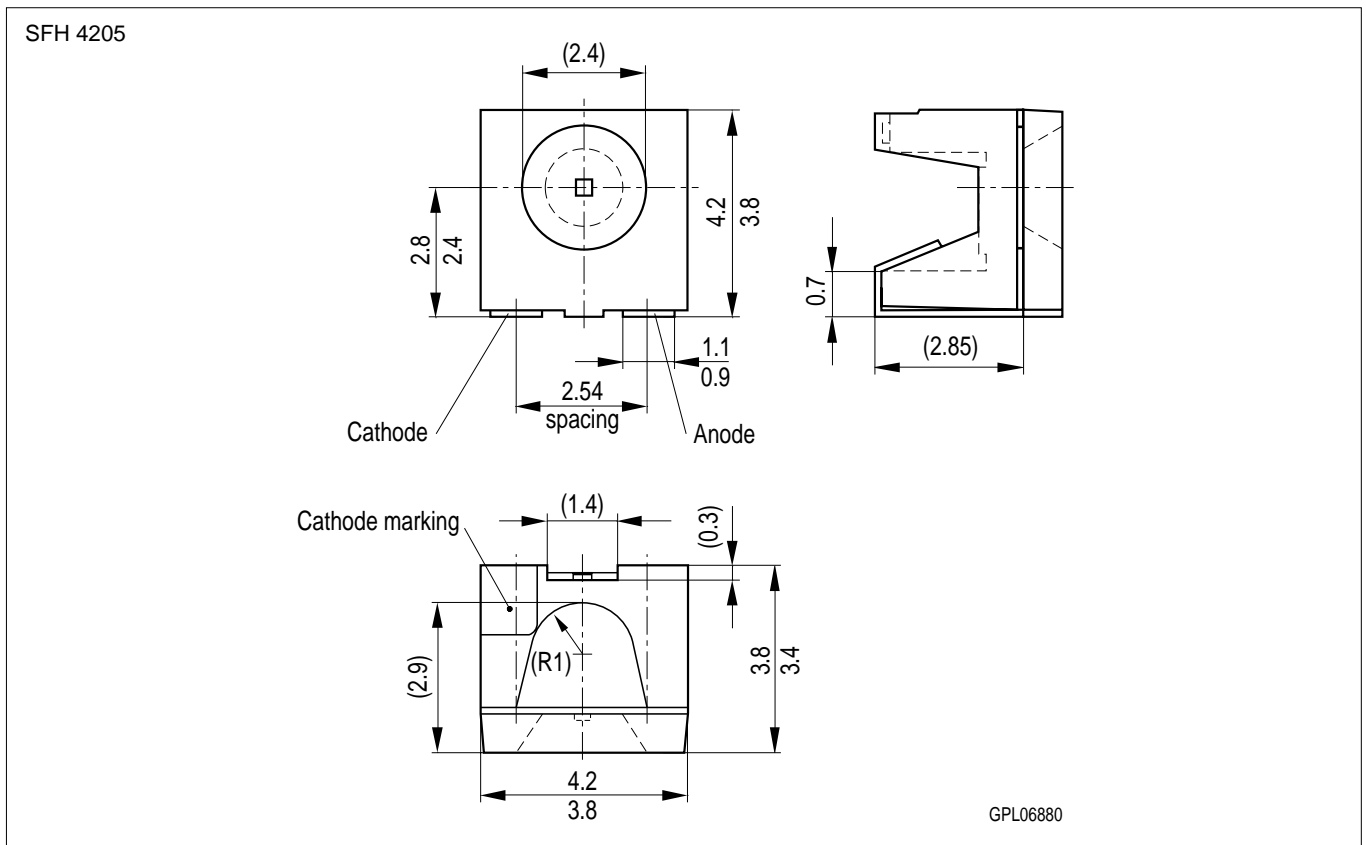
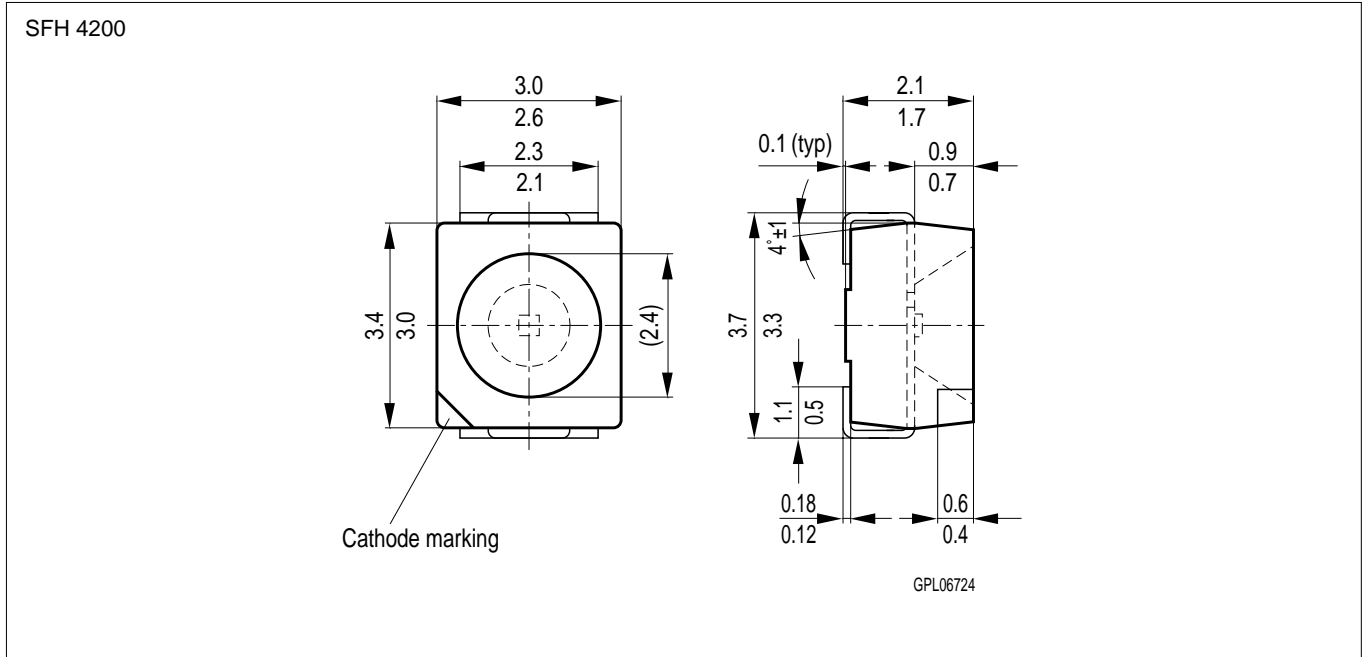


**Radiation Characteristics**  $I_{rel} = f(\varphi)$



1) Thermal resistance junction - ambient mounted on PC-board (FR4), pad size 16 mm<sup>2</sup> (each).

Maßzeichnung  
Package Outlines



Maße in mm, wenn nicht anders angegeben / Dimensions in mm, unless otherwise specified.

**Löthinweise**  
**Soldering Conditions**

Bauform Types	Tauch-, Schwall- und Schlepplötlung Dip, Wave and Drag Soldering		Reflowlötlung Reflow Soldering	
	Lötlbadtemperatur  Temperature of the Soldering Bath	Maximal zulässige Lötzeit  Max. Perm. Soldering Time	Lötzone- temperatur  Temperature of Soldering Zone	Maximale Durchlaufzeit  Max. Transit Time
TOPLED	260 °C	10 s	245 °C	10 s
SIDELED	–	–	245 °C	10 s

Zusätzliche Informationen über allgemeine Lötbedingungen erhalten Sie auf Anfrage.

For additional information on general soldering conditions please contact us.